

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和1年6月20日(2019.6.20)

【公開番号】特開2018-22813(P2018-22813A)

【公開日】平成30年2月8日(2018.2.8)

【年通号数】公開・登録公報2018-005

【出願番号】特願2016-154213(P2016-154213)

【国際特許分類】

H 01 L 21/66 (2006.01)

H 01 L 21/677 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/66 B

H 01 L 21/68 A

【手続補正書】

【提出日】令和1年5月14日(2019.5.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

搬送エリアとメンテナンスエリアとの間に配置された複数の測定部であって、ウエハ上に形成された半導体素子の検査の際に用いられる被メンテナンス装置と、前記被メンテナンス装置を前記メンテナンスエリア側に引き出す引出機構と、を備えた複数の測定部と、
前記測定部と一定距離隔てて設けられ、搬送物を収納する搬送物収納部と、

前記搬送物を前記搬送物収納部から取り出して、前記搬送物を前記搬送先の測定部内に搬送する搬送ユニットと、を備え、

前記被メンテナンス装置の引出方向と前記搬送物の搬送方向とが同じ方向であり、

前記被メンテナンス装置は、テストヘッドであるプローバ。

【請求項2】

前記搬送物はウエハないしはプロープカードである請求項1に記載のプローバ。